（上接B094版）

2014年在国内创先量产了内置1000~1200V智能MOS的超高压AC-DC电源芯片，成功进入国网/南网的智能电表和智能断路器市场，率先实现了电表中高压电源芯片的进口替代，产品线进一步丰富，业务规模快速增长。2016年，公司配合行业高端客户的电源开发需求，基于第四代数字化MOS数字式多片高低压集成平台，开发了全新一代数字化内核的多模式电源管理芯片，陆续推出全模式高功率集成原边反馈开关电源芯片、零瓦待机800V工业开关电源芯片和1000V工业级X-cap放电电源芯片等新品。2019年公司针对工业级通讯电源市场，开发了新一代高可靠、耐冲击、可交互的工业级电源管理芯片，为工业级通讯设备电源管理芯片领域实现进口替代、自主可控做出贡献。

2021年公司工控功率类芯片产品收入11,775.51万元，较2020年增长122.83%，占主营业务收入的比例达到15.75%，工业级产品规模及收入占比持续增长。公司工业驱动类芯片的主打系列包括800V智能保护AC-DC电源芯片系列、1000~1200V工业AC-DC电源芯片系列、零瓦待机AC-DC工业电源芯片系列、600V浮置栅驱动电源芯片系列等，面向包括工控设备、电网集中器、服务器、通讯设备、电机设备等多样化的工业场景。

成功的工业级产品开发经验与开发管理流程为本项目实施提供良好的经验借鉴。

（4）广阔的工业市场为募投项目的实施提供了基础

本项目所涉及的电源管理芯片及配套功率芯片被广泛的应用于数据中心、服务器、基站、光伏逆变器、储能等大功率工业场景。

数据中心方面，其建设加快以及服务器的出货量持续上升，带来电源管理芯片显著的增量需求。根据Wind数据，2007年至2020年期间，我国数据中心市场规模实现持续增长，2020年我国数据中心市场规模达到2,238.70亿元，同比增长43.28%。在服务器领域，2020及2021年，我国整体服务器市场保持稳健增长，根据IDC数据显示，2020年我国服务器市场出货量为350万台，同比增长9.8%，其市场规模达到216.49亿美元，同比增长19.0%。2021年上半年，我国服务器市场出货量为170.6万台，同比增长8.9%，其市场规模达到108.1亿美元，同比增长12.1%。

5G通信方面，2020年我国移动通信基站数达到931万个，其中5G基站数量超过71.8万个。截至2021年9月，我国移动电话基站总数达969万个，同比增长5.7%，其中4G基站总数为586万个，占移动基站总数的60.4%，5G基站总数达到115.9万个，占移动基站总数的12.0%。预计到2022年底，我国5G基站将超过200万个，5G的终端连接数将达到6亿。

新能源方面，光伏逆变器是光伏系统中的重要组件，根据IHS Markit数据及预测，2020年全球光伏逆变器的新增及替换整体市场规模为135.7GW，2021年全球光伏逆变器市场规模将达187GW，预计至2025年全球光伏逆变器市场规模有望达到401GW，CARG达21.0%。

由此，广阔的下游应用领域保障了对公司产品的充足需求，为公司发展提供了巨大的市场空间。

5、投资概算

本项目预计建设期为4年，项目总投资48,819.15万元，拟投入募集资金47,294.66万元。项目具体投资情况如下：

序号	项目	指标	单位
1	项目总投资	48,819.15	万元
2	场地购置、装修费用	1,900.00	万元
3	软硬件设备及IP购置	33,928.00	万元
4	研发费用	11,466.66	万元
5	基本预备费	945.89	万元
6	铺底流动资金	578.60	万元

6、实施主体、项目选址和建设期限

本项目实施主体为公司，项目选址定于江苏省无锡市。

7、项目备案及环评情况

本项目的备案、环评事宜正在推进中。

（三）苏州研发中心项目

1、项目概况

电源管理芯片作为先进设备的核心，下游市场对其技术和性能的要求不断提升。本项目拟通过建立前瞻性技术研发中心，建设一支以数模混合电源芯片和宽禁带智能功率器件为技术方向，包含芯片和器件测试团队、系统应用方案团队、软件团队等全方位一体化的研发设计团队。公司着眼功率半导体行业最新前沿技术领域，定位国际先进水平，为公司始终保持市场需求和技术发展的敏感性、精准选择自身战略定位作出前瞻性布局，不断巩固和提高公司在电源管理芯片领域的优势地位。

2、项目建设内容

本项目具体建设目标如下：

本项目拟通过建立前瞻性技术研发中心，建设一支以数模混合电源芯片和宽禁带智能功率器件为技术方向，包含芯片和器件测试团队、系统应用方案团队、软件团队等全方位一体化的研发设计团队。

同时本项目将极大缓解公司目前日益紧张的办公、实验等场地需求，有利于吸引当地优秀芯片设计人才，推动公司长远可持续发展。此外，苏州研发中心的建立也有利于进一步提升公司形象，在客户群中打造良好的品牌影响力，进而推动公司各项业务的顺利开展。

3、项目实施的必要性

（1）本项目是公司拓展下游目标市场和丰富产品线的必然要求

随着新能源汽车等下游应用领域的技术迭代，以及终端产品种类和功能的不断丰富，电源管理芯片的应用场景愈发广泛，同时也增加了对电源管理芯片协调设备内部各模块供电的难度及复杂程度。

新能源汽车领域方面，新能源汽车和智能驾驶的兴起使得整车中电子电气的应用比例日益提升，汽车的电动化、网联化、智能化及共享化带来了新的应用场景与现有配置升级，功能日益强大的处理器以及逐渐增多的系统外设对电源管理提出了更高的要求，这些新增应用也是国内汽车芯片厂商最好的切入机会，将推动车规级电源及电驱动芯片市场规模进入新的发展阶段。同时，不断崛起的新能源汽车相比于传统的燃油车新增了电池、电机、电控“三电”系统，带动大量的电能转换需求，从而推动上游芯片市场显著的增量需求。

工业领域方面，能耗主要来自于电机和数据中心。其中电机包括泵、风机、压缩机、传输机等，电机消耗的能量几乎占工业电力消耗的80%。工业领域对节能的要求，促使电源芯片不断提高转换效率。比如使用变速电机能节省40%的能耗，使用高效的开关电源可以节省35%的能耗，这均是由更先进的电源芯片支撑。随着数据中心的人工智能处理器的推出，供电功率上限不断提升，对电源管理芯片的集成度和效率提出更高的要求。为了满足下游市场多样化的需求，企业需持续增加研发投入以保持竞争优势。

本项目建设通过引进更多的前沿技术人才，购置相应的先进实验设备，坚持专注公司主营业务方向—电源芯片的前沿技术研发，有助于稳固公司自身的技术“护城河”，始终为市场提供最具竞争力的电源芯片产品，从而提升公司在电源芯片领域的市场地位，项目实施具有必要性。

（2）本项目的实施有助于增加公司高端人才储备

集成电路行业是全球信息产业的基础，在产业资本的驱动下，已经逐渐成为衡量一个国家或地区综合竞争力和经济表现的重要标志。其广泛应用于人们的生活当中，推动了电子时代的发展。集成电路行业属于技术密集型高新技术产业，对于芯片设计行业，人才是技术研发的核心，企业需要不断引进和培养优秀的行业人才以维持产品的科技能力。因此，人才团队的建设和稳定将对公司产品线的突破和创新起到推动作用。

人才紧缺是制约高新技术产业发展的最大痛点之一，为了满足更新迭代周期快的下游市场，公司拟加大研发投入，构建高精尖的人才团队，一方面开展模拟电源管理芯片的更新迭代，另一方面进行数字电源管理芯片的研发，进一步推动对芯片设计行业人才的需求。

本项目将把人才环境建设作为发展战略目标，提供完善的研发环境和管理体系，研究和制定多种灵活的人才引进和培养政策，为公司的研发开展和项目建设提供有效支撑。

（3）本项目建设有助于产业减少对国外技术的依赖

电源管理芯片是电子设备重要的组成部分，为设备的运行输入源源不断的动力，应用领域广泛，如工业领域、家电领域、通讯领域等皆需要电源的使用。目前，中国大陆电源管理芯片设计企业处于上升期，在中小功率相关产品已经实现部分国产化，但大部分电源管理芯片的供应来自于进口，国产厂商发展方兴未艾。因此，企业需要增强技术能力和储备，增加自有知识产权对产品进行拓展研发和升级以满足下游产业的大功率发展趋势。

电源管理芯片行业具有研发周期长、技术难度高等特点，持续的研发投入将为企业带来巨大的竞争优势，公司在电源管理行业深耕16年，积累了大量的行业经验，其中不乏国际先进水平的核心技术。基于现有技术的基础上进行研发有利于公司突破更多技术瓶颈，实现更多产品的国产替代。项目的实施是对公司现有技术水平的继续延伸，有利于提高公司技术储备，构建技术壁垒，巩固公司的竞争地位。

此外，随着公司的不断发展壮大以及技术开发环境要求的不断提升，本项目拟购置新场地，搭建更为完善的实验环境，充分保障技术研发的顺利进行。本项目建设是提升公司整体研发水平，增加自主知识产权，助力我国电源管理芯片行业实现国产替代的重要举措。

4、项目建设的可行性

（1）国家政策的有力支持为本项目实施提供了良好的政策环境

集成电路产业是信息技术产业的核心，电源管理芯片是通电类产品的电能供应中枢和纽带，负责所需电能的变换、分配、检测和控制等功能。实现电源管理领域高端产品细分赛道的国产化，对提升我国在国际芯片舞台上的竞争力具有重大的战略意义。

为了增强我国集成电路的竞争力和自主化，我国政府相继出台了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《国家集成电路产业发展推进纲要》《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》等多项鼓励性政策，从财税、技术、人才、应用、国际合作等多方面予以优惠，持续促进我国集成电路产业发展。

2021年3月，全国人民代表大会审议通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，进一步明确了集成电路领域技术攻关和创新发展在“十四五”期间的重要地位。我国集成电路产业的政策红利显示出了良好的延续性，有利于推动我国电源管理芯片行业的健康发展，为本项目顺利实施提供了可靠的政策保障。

（2）公司核心技术积累为本项目研发目标的顺利实现提供了技术基础

公司是一家专业从事功率集成电路及其解决方案的定义、设计、研发的高新技术企业，在多年的电源管理芯片技术和产品开发实践中，公司取得了丰富的技术及经验积累。截至2021年12月31日，公司累计取得国内外专利84项，其中发明专利65项，另有集成电路布图设计专有权100项。

目前，公司建立了科技创新和知识产权管理的规范体系，在数字/模拟电路设计、半导体器件及工艺设计、可靠性设计、器件模型提取等方面积累了众多核心技术，迭代开发出了4代核心技术平台。此外，公司拥有经验丰富的研发团队，公司核心团队均具有十年以上集成电路行业研发经验，拥有较强的研发实力。自公司成立以来，公司核心团队保持稳定。丰富的技术积累及研发创新能力、优秀的技术研发团队是募投项目顺利实施的重要支撑。

（3）募投项目所在地具备长三角集成电路企业集群优势

我国集成电路主要有四个产业集聚区，分别是以上海为中心的长三角、以北京为中心的环渤海、以深圳为中心的泛珠三角和以武汉、成都为代表的中西部区域。本项目所在地苏州地处长三角，其集成电路产业已形成以“芯片设计-晶圆制造-封装测试”为核心，以设备、原材料及服务产业为支撑的集成电路产业链，是国内产业链较完整的区域之一，有利于公司研发项目的顺利开展以及对产业化项目提供技术支持。

首先，长三角区域半导体企业集聚度高。芯片生产的流程包括芯片设计、生产、封测等步骤，而生产又涉及到原材料采购、加工和清洗等步骤，产业集聚效应减少了产品的运输风险，且提高了生产效率。其次，产业集群更有利于吸引业内人才和培养人才。公司所在的集成电路行业属于技术密集行业，人才梯队建设是企业长期健康发展的基础，由于长三角地区产业链完整，具有人才聚集效应，能够为公司未来的技术研发项目提供更好地支撑。

本项目拟建地址为江苏省苏州市，该地区是国内领先的高新技术成果转化孵化基地，汇聚了多家大中型企业，商业氛围浓厚，为公司吸引高素质的专业人员和多元化人才提供了便利条件。

同时，公司拟在公司现有办公地点附近新购置5,000平方米办公区域用于研发中心办公场地。苏州市地理位置优越，交通便利，各种配套设施齐全，房产交易较为活跃，公司较易取得合适的房产，项目具备可行性。

5、投资概算

本项目预计建设期为4年，项目总投资24,644.15万元，拟投入募集资金24,160.93万元。项目具体投资情况如下：

序号	项目	指标	单位
1	项目总投资	24,644.15	万元
2	场地购置、装修费用	10,350.00	万元
3	软硬件设备及IP购置	4,371.15	万元
4	研发费用	9,439.78	万元
5	基本预备费	483.22	万元

6、实施主体、项目选址和建设期限

本项目实施主体为公司的全资子公司苏州博创集成电路设计有限公司，项目选址定于江苏省苏州市。

7、项目备案及环评情况

本项目的备案、环评事宜正在推进中。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。本次募集资金投资项目的实施有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，提高公司盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行完成后，公司的资本实力进一步增强。公司的总资产和净资产规模均会有所增长，营运资金得到进一步充实。同时，公司资产负债率将相应有所下降，公司的资本结构将得到优化，有利于增强公司的偿债能力，降低公司的财务风险。随着本次募投项目的顺利实施以及募集资金的有效使用，项目效益的逐步释放将提升公司运营规模和经济效益，从而为公司和股东带来更好的投资回报并促进公司健康发展。

四、总结

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及全体股东的利益。同时，本次向特定对象发行可以提升公司的盈利能力，优化公司的资本结构，为后续业务发展提供保障。

无锡芯朋微电子股份有限公司
董事会
2022年3月18日

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2022-022

无锡芯朋微电子股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“芯朋微”、“本公司”或“公司”）编制了截止2021年12月31日前次募集资金使用情况的报告。（下文中所有金额涉及的货币币种如无特别说明，均为人民币）

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡芯朋微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1216号）同意，本公司由主承销商华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）28,200,000股，每股面值1元，发行价格为28.30元/股，募集资金总额798,060,000.00元，扣除尚未支付的承销、保荐费价税合计人民币64,137,657.20元后的金额人民币733,922,342.80元，由华林证券于2020年7月17日汇入本公司募集资金专户，另扣除保荐费、审计费、律师费等其他发行费用11,431,267.08元，本公司实际募集资金净额为人民币722,491,075.72元，由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具苏公W[2020]B069号验资报告。

（二）前次募集资金存放和管理情况

1、前次募集资金在各银行专项账户的存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

截止2021年12月31日，本公司为2020年首次公开发行股票募集资金开立5个募集资金专户，存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行无锡滨湖支行	8110501012201559911	426.96	活期存款
招商银行无锡新区支行	510904133110101	106,378,336.35	活期存款
招商银行无锡新区支行	510904133132501	–	美元户
交通银行无锡新区支行	322000640013000353108	109,286,733.67	活期存款
工商银行无锡梁溪支行	1103020129200037665	70,627,162.25	活期存款
合计		286,292,659.23	–

募集资金专户理财产品期末余额情况如下：

开户银行/机构	产品名称	产品类型	起始日-到期日	成本（元）
中信建投证券	看涨宝080期	保本浮动收益	2021/9/17-2022/9/15	50,000,000.00
中信建投证券	看涨宝086期	保本浮动收益	2021/10/14-2022/1/14	38,000,000.00
工商银行无锡梁溪支行	结构性存款	保本浮动收益	2021/12/29-2022/4/6	170,000,000.00
合计				258,000,000.00

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据本公司《募集资金管理办法》，公司连同保荐机构华林证券于2020年7月17日分别与招商银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司无锡梁溪支行、交通银行股份有限公司无锡分行和中信银行股份有限公司无锡分行签订了《资金专户存储三方监管协议》。根据公司业务需要，部分设备需从国外进口，需要支付外币进行结算，2020年11月6日公司连同保荐机构华林证券与招商银行股份有限公司无锡分行签订外币的《资金专户存储三方监管协议》。

（三）前次募集资金使用及结余情况

截止2021年12月31日，前次募集资金累计使用情况：

项目	金额（元）
募集资金净额	722,491,075.72
减：募集资金投资项目支出	152,420,834.94
加：募集资金专项账户利息收入	3,217,785.93
减：募集资金专项账户手续费支出	8,020.65
减：购买理财产品支出	2,862,000,000.00
加：赎回理财产品收入	2,604,000,000.00
加：募集资金专项账户理财产品收益	17,812,653.17
减：永久性补充流动资金	46,800,000.00
募集资金专项账户实际余额	286,292,659.23

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用对照情况

截止2021年12月31日，本公司前次募集资金实际使用对照情况见“附件1：前次募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截止2021年12月31日，本公司前次募集资金投资项目未发生变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止2021年12月31日，本公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2021年12月31日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2020年8月6日公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用单日最高余额不超过72,000万元（包含本数）的首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品。2020年度，公司使用前次募集资金购买理财产品共计47,400.00万元，截止2020年12月31日均已到期赎回，产生投资收益共计387.49万元（含税）。

2021年8月6日公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用单日最高余额不超过59,800万元（包含本数）的首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品。2021年度，公司使用前次募集资金购买理财产品共计231,300.00 万元，到期赎回理财产品共计205,500.00 万元，产生投资收益共计1,393.78万元（含税）。

（五）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年10月23日公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金4,680万元用于永久性补充流动资金。

（六）前次募集资金其他使用情况

2020年10月23日公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用公司基本户支付募投项目人员费用，之后定期以募集资金等额置换并从募集资金专户划转至公司基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截止2021年12月31日共发生募投项目人员费用置换685.00万元。

（七）尚未使用的前次募集资金情况

截止2021年12月31日，前次募集资金尚未使用金额为54,429.27万元（与募集资金净额的差异为2,102.24万元，其中1,792.95万元为使用闲置募集资金进行现金管理获得的投资收益，309.29万元为募集资金专户累计获得的利息收入净额），系项目尚在建设过程中而未使用。因使用暂时闲置募集资金进行现金管理而购买的理财产品金额为25,800万元，截止2021年12月31日，募集资金专项账户余额为28,629.27万元。

三、前次募集资金投资项目实现效益对照情况

前次募集资金投资项目实现效益对照情况，见“附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司不存在前次募集资金用于资产认购股份的资产运行情况。

五、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件1：前次募集资金使用情况对照表

附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告

无锡芯朋微电子股份有限公司
董事会
2022年3月18日

附件1：

前次募集资金使用情况对照表

截止日：2021年12月31日

编制单位：无锡芯朋微电子股份有限公司		金额单位：人民币万元	
募集资金总额	72,249.11	已累计使用募集资金总额	19,922.08
变更用途的募集资金总额	–	各年度使用募集资金总额	
变更用途的募集资金总额比例	–	2020年度	14,776.06
		2021年度	5,146.02

投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资金额	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资金额		
研发中心建设项目	研发中心建设项目	7,495.09	7,495.09	2,530.08	7,495.09	7,495.09	2,530.08	-4,965.01	2022年上半年
大功率电源管理芯片开发及产业化项目	大功率电源管理芯片开发及产业化项目	17,566.35	17,566.35	7,660.46	17,566.35	17,566.35	7,660.46	-9,905.89	2022年上半年
工业级驱动芯片的模块开发及产业化项目	工业级驱动芯片的模块开发及产业化项目	15,515.14	15,515.14	5,051.55	15,515.14	15,515.14	5,051.55	-10,463.59	2022年上半年
补充流动资金	补充流动资金	16,000.00	16,000.00	–	16,000.00	16,000.00	–	-16,000.00	不适用
超募资金项目	超募资金项目			4,680.00			4,680.00		不适用
其中：补充流动资金		–	–	4,680.00	–	–	4,680.00	–	不适用
合计				19,922.08			19,922.08		–

附件2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日：2021年12月31日

编制单位：无锡芯朋微电子股份有限公司　　金额单位：人民币万元

实际投资项目	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益		实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
项目名称		2020年度	2021年度	2020年度	2021年度		
研发中心建设项目	不适用	建设期	建设期	–	–	–	不适用
大功率电源管理芯片开发及产业化项目	不适用	建设期	建设期	–	–	–	不适用
工业级驱动芯片的模块开发及产业化项目	不适用	建设期	建设期	–	–	–	不适用
补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 编号：2022-023

无锡芯朋微电子股份有限公司关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重大提示：

无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“芯朋微”）本次向特定对象发行A股股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，公司就本次向特定对象发行A股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，具体措施说明如下：

一、本次向特定对象发行对公司每股收益的影响测算

（一）测算假设及前提

1、假设公司所处的宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；

2、不考虑本次募集资金到位后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

3、假设本次发行于2022年9月末完成，该预测时间仅用于测算本次发行摊薄即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会作出予以注册决定后的实际完成时间为准；

4、本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过33,929,550股，募集资金总额不超过109,883.88万元。因此，假设本次发行数量为33,929,550股，发行后公司总股本为147,028,050股，募集资金总额为109,883.88万元，未考虑发行费用及股票回购注销等因素的影响。本假设不对本次发行的数量、募集资金金额做出承诺，仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。本次发行的实际发行股份数量、到账的募集资金规模将根据监管部门审核情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

5、根据公司披露的2021年年度报告，2021年度归属于母公司股东的净利润为20,128.09万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,192.19万元。假设2022年度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别较2021年度增长10%、增长20%和增长30%三种情况测算。该假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对2022年度经营情况及趋势的判断，亦不构成对本公司的盈利预测；

6、在预测本次发行后净资产时，不考虑除现金分红、募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响，并假设2022年度权益分配金额与经第四次董事会第九次会议审议通过的《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》金额相等；

7、假设2022年12月31日归属母公司所有者权益=2022年期初归属于母公司所有者权益+2022年归属于普通股股东的净利润-2021年度现金分红额+本次向特定对象发行募集资金总额；

8、在预测期末发行在外的普通股股数时，以预案公告日的总股本113,098,500股为基数，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑股票回购注销、公积金转增股本等导致股本变动的情形；

9、不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

以上仅为基于测算目的的假设，不构成承诺及盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提，公司测算了本次发行对每股收益的影响，测算结果如下表所示：

项目	2021年度/2021年12月31日	2022年度/2022年12月31日	
		发行前	发行后
假设1：假设公司2022年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2021年度增长10%			
普通股股数（万股）	11,309.85	11,309.85	14,702.81
期初归属于母公司的所有者权益（万元）	129,110.09	151,467.73	151,467.73
归属于普通股股东的净利润（万元）	20,128.09	22,140.90	22,140.90
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（万元）	15,192.19	16,711.40	16,711.40
本期现金分红（万元）	3,384.00	6,785.91	6,785.91
向特定对象发行增加净资产（万元）	–	–	109,883.88
期末归属于母公司的所有者权益（万元）	151,467.73	166,822.72	276,706.60
基本每股收益（元/股）	1.7844	1.9577	1.8211
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	1.3468	1.4776	1.3745
稀释基本每股收益（元/股）	1.7803	1.9528	1.8169
扣除非经常性损益后稀释基本每股收益（元/股）	1.3438	1.4739	1.3713
加权平均净资产收益率	14.45%	13.69%	11.70%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	10.91%	10.33%	8.83%
假设2：假设公司2022年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2021年度增长20%			
普通股股数（万股）	11,309.85	11,309.85	14,702.81
期初归属于母公司的所有者权益（万元）	129,110.09	151,467.73	151,467.73
归属于普通股股东的净利润（万元）	20,128.09	24,153.71	24,153.71
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（万元）	15,192.19	18,230.62	18,230.62
本期现金分红（万元）	3,384.00	6,785.91	6,785.91
向特定对象发行增加净资产（万元）	–	–	109,883.88
期末归属于母公司的所有者权益（万元）	151,467.73	168,835.53	278,719.40
基本每股收益（元/股）	1.7844	2.1356	1.9866
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	1.3468	1.6119	1.4995
稀释基本每股收益（元/股）	1.7803	2.1304	1.9821
扣除非经常性损益后稀释基本每股收益（元/股）	1.3438	1.6079	1.4960
加权平均净资产收益率	14.45%	14.84%	12.70%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	10.91%	11.20%	9.58%
假设3：假设公司2022年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2021年度增长30%			
普通股股数（万股）	11,309.85	11,309.85	14,702.81
期初归属于母公司的所有者权益（万元）	129,110.09	151,467.73	151,467.73
归属于普通股股东的净利润（万元）	20,128.09	26,166.52	26,166.52
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（万元）	15,192.19	19,749.84	19,749.84
本期现金分红（万元）	3,384.00	6,785.91	6,785.91
向特定对象发行增加净资产（万元）	–	–	109,883.88
期末归属于母公司的所有者权益（万元）	151,467.73	170,848.34	280,732.21
基本每股收益（元/股）	1.7844	2.3136	2.1522
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	1.3468	1.7463	1.6244
稀释基本每股收益（元/股）	1.7803	2.3079	2.1472
扣除非经常性损益后稀释基本每股收益（元/股）	1.3438	1.7419	1.6207
加权平均净资产收益率	14.45%	15.98%	13.68%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	10.91%	12.06%	10.33%

二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次向特定对象发行募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标可能出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险。

同时，在相关法律法规下，公司在测算本次向特定对象发行对即期回报的摊薄影响过程中对2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的假设分析以及为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施，并不构成公司的盈利预测，填补回报具体措施不代表对公司未来利润任何形式的保证。投资者不应据此进行投资决策，提请广大投资者注意。

三、董事会选择本次融资的必要性和合理性

（一）满足本次募集资金投资项目的资金需求

为把握行业发展契机，丰富公司产品结构，进一步拓展公司主营业务，提升公司的盈利能力，公司拟通过本次募集资金用于新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目、工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目和苏州研发中心项目。

通过实施新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目、工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目，有利于公司进一步拓展公司电源管理芯片的业务范围，扩展公司电源管理芯片业务的产品结构，提升公司在电源管理芯片设计领域的竞争力；同时公司将建设苏州研发中心项目，以满足公司利用长三角集成电路企业集群优势、探索前沿技术研究的需求，持续保持公司的科创实力。

前述募集资金投资项目所需资金规模较大，若全部由公司以自有资金和债权融资投入，公司将面临较大的资金压力和偿债压力。故公司通过本次向特定对象发行股票募集资金，能够有效解决上述项目的资金需求，保障募集资金投资项目的顺利实施。

（二）符合公司经营发展规划

本次向特定对象发行A股股票募集资金的运用符合公司战略发展方向。募集资金到位后，有助于提高公司的资本实力，增强公司的风险防范能力，提高公司的综合竞争力，提升公司在行业内的地位为公司带来新的业绩增长点。因此，本次向特定对象发行A股股票对公司经营发展有着积极的意义，有利于公司长期稳定的可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

（三）向特定对象发行股票是公司现阶段最佳的融资方式

与股权融资相比，通过贷款融资和通过发行债券的方式进行资金筹集会为公司带来较高的财务成本。如公司通过上述两种方式进行融资，一方面会导致公司整体资产负债率上升，提高公司的财务风险，降低公司偿债能力和抗风险能力，另一方面会产生较高的利息费用，挤压降低公司整体的利润空间，不利于公司的稳健发展。公司通过股权融资可以有效降低偿债压力，有利于保障本次募投项目的顺利实施，保持公司资本结构的合理稳定。

综上，公司本次向特定对象发行A股股票募集资金具有必要性。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司本次募集资金投资项目为新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目、工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目和苏州研发中心项目，旨在完善市场布局，提高公司核心技术竞争力、加强项目产品线配套封测产能保障，并新建苏州研发中心以满足公司利用长三角集成电路企业集群优势、探索前沿技术研究的需求，持续保持公司的科创实力。因此，本次募集资金主要投向科技创新领域，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，服务于国家创新驱动发展战略及国家经济高质量发展战略。

（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

公司通过自主培养为主、外部引进为辅的方式培养了一支具有竞争力的技术研发团队。截至2021年12月31日，公司拥有研发人数215人，占总员工数量的比例为75.44%，其中拥有研究生学历的研发人员占总研发人员数量的比例为32.56%，公司核心技术人员均拥有多年丰富的集成电路设计研发经验和深厚的技术背景。

2、技术储备

公司建立了科技创新和知识产权管理的规范体系，在数字/模拟电路设计、半导体器件及工艺设计、可靠性设计、器件模型提取等方面积累了众多核心技术，迭代开发出了4代核心技术平台。截至2021年12月31日，公司拥有84项已授权的国内和国际专利，100项集成电路布图登记，15项原始创新的核心技术，其中5项属国际先进技术水平，分别为智能功率器件高低压集成工艺技术、超低功耗高压启动技术、200V-1200V螺旋形电场均衡场板的器件新结构技术、40V-1200V SmartMOS器件过流保护技术以及600V高压隔离浮置栅半桥驱动技术。

3、市场储备

公司多年来专注于高压电源管理及控制领域，积累了业内领先的高压电源和驱动类芯片可靠性设计和管控经验。公司向客户整机系统提供从高压到低压的全套电源方案，在高压电源和驱动芯片领域具有国内领先的研发实力。公司在国内创先开发成功并量产了单片700V高低压集成开关电源芯片、1200V高低压集成开关电源芯片、零瓦待机高低压集成开关电源芯片等产品，均获得国家/省部级科技奖励和国家重点新产品认定。多年积累的高压电源和驱动可靠性设计和管控能力为公司拓展下游领域、布局汽车赛道打下了坚实的基础。

从工业级产品开发经验来看，2019年公司针对工业级通讯电源市场，开发了新一代高可靠、耐冲击、可交互的工业级电源管理芯片，为工业级通讯设备电源管理芯片领域实现进口替代、自主可控做出贡献。公司工业驱动类芯片的主打系列包括800V智能保护AC-DC电源芯片系列、1000~1200V工业AC-DC电源芯片系列、零瓦待机AC-DC工业电源芯片系列、600V浮置栅驱动电源芯片系列等，面向包括工控设备、电网集中器、服务器、通讯设备、电机设备等多样化的工业场景。

综上，公司本次募集资金投资项目围绕公司现有主营业务展开，在人员、技术、市场等方面均具有良好基础。随着募集资金投资项目的建设，公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备，确保项目的顺利实施。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为保护投资者利益，保证公司募集资金的有效使用，增强公司的可持续发展能力，提高对公司股东回报的能力，公司拟采取如下填补措施：

（一）加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用

公司已按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求制定了募集资金管理制度。公司将根据相关法律法规和募集资金管理制度的相关要求，规范募集资金的管理与使用，确保本次募集资金专项用于募投项目。公司将定期检查募集资金使用情况，保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

（二）加快公司主营业务的发展，提高公司盈利能力

本次发行募集资金将主要投入新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目、工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目和苏州研发中心项目，上述募集资金投资项目与公司主营业务密切相关，项目实施后，将进一步扩大公司的业务规模，提高公司的核心竞争力。本次发行募集资金到位后，公司将加快募集资金投资项目建设的推进，力争早日实现预期收益，从而降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。

（三）完善公司治理，为企业发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，公司发展提供制度性保障。确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权、作出决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司的整体利益和股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权。

（四）完善利润分配政策，重视投资者回报

为健全和完善公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，公司已经制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。本次发行后，公司将严格执行利润分配规定，切实保障投资者合法权益。

六、公司的董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人对公司本次向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。

为维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报采取的措施得到切实履行做出了承诺，具体如下：

（一）公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺

为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员做出如下承诺：

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行A股股票实施完毕前，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

7、若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

（二）公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺

为确保公司本次向特定对象发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：

1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行A股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

3、若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司
董事会
2022年3月18日

无锡芯朋微电子股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划

为健全无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“芯朋微”）科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）等文件要求和《公司章程》的相关规定，公司制定了《无锡芯朋微电子股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。

第一条 本规划考虑的因素

公司着眼于长远和可持续发展，以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并给予投资者稳定回报。在综合分析公司经营发展现状、发展目标、股东意愿、当前及未来盈利规模、现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，结合公司所处行业的特点、发展趋势等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

第二条 本规划的制定原则

在符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的前提下，公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报及兼顾公司的可持续发展，充分听取股东特别是中小股东的意见和诉求，并结合独立董事、监事的意见，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

第三条 未来三年（2022年-2024年）的具体股东分红回报规划

一、利润分配形式

在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采取现金方式分配股利；在预计公司未来将保持较好的发展前景，且公司发展对现金需求较大的情形下，公司可采用股票分红的方式分配股利。

二、利润分配的期间间隔

在满足利润分配条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，并提交股东大会审议批准。

三、利润分配的条件和比例

1、现金分配的条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；公司累计可供分配利润为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司不存在重大投资计划或重大现金支出等特殊事项（募集资金项目除外），重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计归属于母公司净资产的30%。

2、实施股票分红的条件：在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适用，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

3、现金分红的比例：公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，原则上公司每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的20%。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排的，可以按照前项规定处理。

四、利润分配的决策机制与程序

1、董事会制定年度利润分配方案、中期利润分配方案，独立董事应对利润分配方案单独发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

2、监事会应当审议利润分配方案，并作出决议。

3、董事会和监事会审议并通过利润分配方案后提交股东大会审议批准。

4、股东大会审议利润分配方案。公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。股东对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于股东热线电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

五、利润分配政策调整

1、公司应当严格执行章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。当公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，或根据投资规划和长期发展需要等确需调整利润分配方案的，应当满足章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；独立董事应对调整或变更的理由的真实性、充分性、合理性、审议程序的真实性和有效性以及是否符合章程规定的条件等事项发表明确意见，且公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，并及时答复中小股东关心的问题，必要时，可通过网络投票系统征集股东意见。

下列情况为上述所称的外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化：

（1）因国家法律法规、行业政策发生重大变化，非因公司自身原因而导致公司经审计的净利润为负；

（2）因出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经审计的净利润为负；

（3）出现《公司法》规定不能分配利润的情形；

（4）公司经营活动产生的现金流量净额连续两年均低于当年实现的可供分配利润的10%；

（5）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

2、公司调整现金分红政策的具体条件：

（1）公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；

（2）自利润分配的股东大会召开日后的两个月内，公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利；

（3）按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；

（4）董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。

六、利润分配信息披露机制

公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利且满足现金分红条件，但董事会未作出现金利润分配方案的，公司应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见、监事会发表意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。

第四条 股东分红回报规划的制定周期

公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公司实际情况调整规划，经董事会审议通过并提交公司股东大会审议通过后方可实施。

公司至少每三年重新审阅一次本规划，并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当调整，以确定该时段的股东回报规划。

第五条 本规划的生效机制

本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

无锡芯朋微电子股份有限公司
董事会
2022年3月18日

无锡芯朋微电子股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“芯朋微”或“公司”）根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行A股股票方案及实际情况，对2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》，具体内容如下：

一、公司的主营业务

公司为集成电路设计企业，主营业务为电源管理集成电路的研发和销售。公司专注于开发以电源管理集成电路为主的功率半导体产品，实现进口替代，为客户提供高效能、低功耗、品质稳定的芯片产品，推动整机的能效提升和技术升级。

公司主要产品为电源管理芯片，目前有效的电源管理芯片共计超过1200个型号。公司一直坚持以市场需求为导向、以创新为驱动，积极开发新产品，研发了三大类应用系列产品线，包括家用电器类、标准电源类和工控功率类等，广泛应用于家用电器、手机及平板的充电器、机顶盒及笔记本的适配器、车载充电器、智能电表、工控设备等众多领域。

二、本次募集资金投向方案

本次向特定对象发行A股股票总金额不超过109,883.88万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟使用募集资金金额
1	新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目	39,779.57	38,428.29
2	工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目	48,819.15	47,294.66
3	苏州研发中心项目	24,644.15	24,160.93
合计		113,242.87	109,883.88

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

（一）新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目

1、项目概况

在碳达峰、碳中和的政策背景下，新能源汽车行业逐步成为高成长性赛道，市场对汽车电子的需求相应大幅上升。本项目拟实施面向新能源汽车的高压电源及电驱功率芯片研发及产业化，产品主要用于新能源汽车OBC（车载充电机）、PDU（高压配电单元）及电驱系统。本项目将开发面向400V/800V电池的高压电源转换分配系统、高压驱动系统的系列芯片，包括高压电源控制芯片、高压半桥驱动芯片、高压隔离驱动芯片、高压辅助电源芯片以及智能IGBT和SiC器件，并配套建设车规级半导体可靠性实验中心及封测产线。本项目将公司在工业电源领域积累的平台技术，升级拓展应用到新能源汽车领域，将强化公司在高压电源和高压驱动领域的技术深度和技术积累，获取更大的市场空间，为公司提供良好的投资回报和经济效益。同时，通过本项目的实施，公司将形成车规级电源及电驱芯片的相关知识产权，进一步增强公司技术实力，拓展产品领域。

2、项目建设内容

本项目具体建设内容如下：

（1）高压电源控制芯片：拟采用基于32-bit计算核的高性能可编程数字电源控制器方案，包括数字硬件PID运算单元、高精度PWM定时器、浮点数运算单元、高速闪存等，以充分满足车用高压高效率电源中灵活、高效、可靠的控制需求，并满足汽车功能安全要求标准。

（2）高压半桥驱动芯片：将现有的600V半桥驱动芯片耐压提升到1200V，芯片具有CMTI耐量高、抗负压能力强优点。高压隔离驱动芯片采用容隔离技术，具有5kV绝缘耐压等级，可实现低于100ns的传输延时。满足汽车功能安全要求标准。

（3）高压辅助源芯片：基于芯朋微现有成熟高压辅助源芯片系列技术，特别针对于新能源汽车400V及800V高压电池组，开发高压Buck和高压Flyback转换器芯片，用于为车载系统中的电源控制芯片及驱动芯片供电，芯片集成800V-1200V的MOS器件，集成高压启动和采样功能，满足汽车功能安全要求标准，系统精简，可靠稳定。

（4）650V/1200V智能IGBT器件：将采用深亚微米沟槽栅型复合场终止技术和先进背面减薄工艺，并创新性地集成智能保护电路、电流/温度采样电路和肖特基二极管等，实现极低的工作损耗和突出的应用便利性，并与芯朋微的驱动芯片和控制芯片一并组成整体功率解决方案。

（5）650V/1200V智能SiC器件：将采用沟槽栅MOSFET技术，重点提升其槽栅可靠性，并创新性地集成智能保护电路、电流/温度采样电路、SiC肖特基二极管等，为大功率车用电源和逆变器提供低损耗、高可靠和强智能的最佳主开关器件，并与芯朋微的驱动芯片和控制芯片一并组成整体功率解决方案。

3、项目实施的必要性

（1）本项目是紧跟国家政策、实现国产替代的重要举措

汽车芯片出于对特殊工作环境下安全性能的考虑，具有技术标准高、测试周期长等特点。英飞凌、德州仪器等国外龙头厂商凭借先发优势垄断汽车芯片国际市场的过半份额，国内芯片设计行业起步较晚，在汽车电子领域尚处于技术攻坚的成长阶段，市占率较低。中国作为全球最大的汽车生产国和全球最大的汽车消费市场，处于产业链上游的汽车芯片仍长期依赖进口，汽车电子系统是汽车产业链的核心与基础，在中美贸易争端的时代背景下，汽车芯片的国产化是保障汽车产业长期健康发展的必然要求，汽车芯片的国产替代已上升至国家战略层面。

2020年2月24日，国家发改委等11部委联合发布《智能汽车创新发展战略》，明确提出突破智能计算平台以及车规级芯片等关键技术。2020年9月，科技部、工信部、国创中心在京成立中国汽车芯片创新联盟，旨在建立我国汽车芯片产业创新生态，打破行业壁垒，补齐行业短板，实现我国汽车芯片产业的自主安全可控和全面快速发展。本项目布局汽车领域，完善可与国际巨头比肩的汽车电子产品线，是紧跟国家政策、实现半导体行业国产替代的重要举措。

（2）布局新能源汽车领域是公司把握行业发展机遇、推动业务发展的有效措施

新能源汽车和智能驾驶的兴起使得整车中电子电气的应用比例日益提升。汽车的电动化、网联化、智能化及共享化带来了新的应用场景与现有配置升级，功能日益强大的处理器以及逐渐增多的系统外设对电源管理提出了更高的要求，这些新增应用也是国内汽车芯片厂商最好的切入机会，将推动车规级电源及电驱动芯片市场规模进入新的发展阶段。同时，新能源汽车相比于传统的燃油车新增了电池、电机、电控“三电”系统，带动大量的电能转换需求，从而推动上游芯片市场显著的增量需求。

公司将以自身擅长的高压电源和高压驱动领域作为切入点，以现有车规级的技术储备为基础，扩大研发团队规模，积极探索功率芯片在汽车领域的深度应用，形成完整的功率解决方案。本项目的实施有助于公司把握新能源汽车国产替代的行业机遇，实现业务战略的继续延伸，是公司不断优化产品结构、进一步拓展业务规模、扩大市场份额、新增利润增长点的有效措施。

（3）共建封测产线将提高公司核心技术竞争力，加强项目产品线配套封测产能保障

汽车芯片行业技术标准要求较高，需要经过长周期的质量管理、功能安全、信息安全等标准检测与认证，才能进入产业链应用。在高端产品的后道生产工序中，通过与封测厂共建封测产线，有利于公司实现芯片设计与模块封装的技术协同创新和持续迭代优化，提高公司高密度功率封装方面的核心技术竞争力，形成智能电源管理芯片、功率控制芯片和功率模块的组合产品优势，提升公司在目标市场的产品线覆盖率。

公司旨在布局汽车电子领域的高端产品，共建封测产线是在后续发展阶段巩固和加强公司自身优势的重要举措。本项目将在进一步加强项目产品线配套封测产能保障，提升产品的可靠性、良率与供货能力，稳定公司的大规模交付供给。

4、项目建设的可行性

（1）国家相关产业发展规划为本项目提供了有力的政策支持

在全球新一轮科技革命和产业变革下，汽车产业发展方式正发生深刻变化，新能源汽车已成为全球汽车产业转型升级的重要标志，已经成为我国大力发展的战略性新兴产业之一。

2017年4月，国家发改委、工信部、科技部发布的《汽车产业中长期发展规划》指出针对产业短板，支持优势企业开展政产学研用联合攻关，重点突破动力电池、车用传感器、车载芯片、电控系统、轻量化材料等工程化、产业化瓶颈，鼓励发展模块化供货等先进模式以及高附加值、知识密集型等高端零部件。

2020年11月，国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》明确将着力推动突破车规级芯片、车用操作系统、新型电子电气架构、高效高密度驱动电机系统等关键技术和产品，作为实施新能源汽车基础技术提升工程的重要一环。2020年11月，工信部电子信息发布的《汽车半导体供需对接手册》提出工信部将积极引导和支持汽车半导体产业发展。同时，通过汽车半导体供需对接平台等方式加强供应链建设，加大产能调配力度，为产业平稳健康发展提供有力支撑。

国家相关政策的陆续出台为汽车半导体产业健康、快速发展营造了良好的环境。

（2）新能源汽车产业逐步成为高成长性赛道，本项目具备市场保障

汽车产业是我国国民经济的支柱性产业，我国是全球第一大汽车生产国和消费国。由于石油储量有限且为不可再生资源，传统燃油车不能永续发展，用新能源汽车替代燃油车已经成为全球共识。新能源汽车是实现“双碳”目标的重要抓手，对于保障国家能源安全、促进社会经济发展具有重要的战略意义。国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出，到2025年，我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。

新能源汽车行业在政策与市场双轮驱动之下，开始逐步成为高成长性赛道。根据中国汽车工业协会统计数据，2021年国内电动汽车产销量分别为354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率提升至13.4%，相对2020年提升8%，进一步说明了电动汽车产业已经从政策驱动转向市场拉动。电动汽车表现出色，蓬勃发展，作为电动汽车电子控制系统的汽车芯片，其市场需求大幅提升，广阔的市场需求将为公司布局汽车电子领域、拓展产品应用场景提供市场保障。

（3）多年积累的高压电源和驱动可靠性设计和管控能力为本项目实施奠定基础

公司多年来专注于电源管理功率半导体领域，积累了业内领先的高压电源和驱动类芯片可靠性设计和管控经验。2019年公司承担并顺利完成“超快动态响应自供电高压电源管理电路系列产品研发及产业化”等6项省级重大科研项目，在高压电源和驱动电路设计、半导体器件及工艺设计、可靠性设计等方面积累了完备的知识产权体系和独特的技术优势。同时，公司向客户整机系统提供从高压到低压的全套电源方案，在高压电源和驱动芯片领域具有国内领先的研发实力。公司在国内创先开发成功并量产了单片700V高低压集成开关电源芯片、1200V高低压集成开关电源芯片、零瓦待机高低压集成开关电源芯片等产品，均获得国家/省部级科技奖励和国家重点新产品认定。多年积累的高压电源和驱动可靠性设计和管控能力为公司拓展下游领域、布局汽车赛道打下了坚实的基础。

（4）公司强大的研发团队为本项目顺利实施提供了坚实基础

公司自成立以来专注于以电源管理为主的模拟及数模混合集成电路设计，尤其在高低压集成半导体技术领域具有较强的行业领先优势。公司以核心技术创新研发为企业基因，旨在为客户提供高效能、低功耗、品质稳定的集成电路产品与全面一站式的应用解决方案。公司深耕电源管理芯片十余年，现有博士后企业工作站和江苏省功率集成电路工程技术中心等人才培育中心，截至2021年12月31日，公司拥有研发人员215人，占总员工数量的比例为75.44%，其中拥有研究生学历的研发人员占总研发人员数量的比例为32.56%，公司核心技术人员均拥有多年丰富的集成电路设计研发经验和深厚的技术背景。同时，公司拥有84项已授权的国内外专利，100项集成电路布图专有权。

公司经验丰富的研发团队及技术储备为项目实施提供了支持。

5、投资概算

本项目预计建设期为4年，项目总投资39,779.57万元，拟投入募集资金38,428.29万元。项目具体投资情况如下：

序号	项目	金额	单位
1	项目总投资	39,779.57	万元
2	场地购置、装修费用	1,725.00	万元
3	软硬件设备及IP购置	24,921.63	万元
4	研发费用	11,781.66	万元
5	基本预备费	768.56	万元
6	铺底流动资金	582.72	万元

6、实施主体、项目选址和建设期限

本项目实施主体为公司，项目选址定于江苏省无锡市。

7、项目备案及环评情况

本项目的备案、环评事宜正在推进中。

（二）工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目

1、项目概况

本项目拟面向数据中心、服务器、基站、光伏逆变器、储能等大功率工业场景，实施工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发、测试及产业化，主要开发产品包括大功率数字电源控制芯片、集成桥式驱动和智能采样的高频开关模块、高频GaN驱动芯片、智能GaN器件及GaN模块，并配套建设工业级半导体测试中心。

本项目将通过数字电源管理芯片产品的技术研发与产业化应用，提升公司电源管理芯片的性能指标并拓展产品品类，抢占工业场景的市场先机，提升市场覆盖范围，为公司提供良好的投资回报和经济效益。

2、项目建设内容

本项目具体建设内容如下：

（1）高压数字电源控制芯片：基于公司已有的数字电源设计平台，开发集成32-bit数字内核，集成数字PID控制，可实现多相并联控制，用于多相并联Buck电源主控芯片。

（2）集成桥式驱动芯片和智能采样的高频开关模块：基于公司成熟可靠的工业级半桥驱动产品系列技术，将半桥驱动、高低侧功率器件、高精度电流采样、高精度温度采样集成在一颗芯片内，实现MHz的PWM开关。

（3）GaN模块及智能GaN器件：GaN模块将高频GaN驱动芯片、智能GaN及电源控制器集成在一个模块封装内，实现更小体积的工业电源方案。高频GaN驱动芯片是基于公司的宽禁带器件底层技术，研发具有开启分段驱动，关断负压驱动功能的先进GaN驱动芯片。智能GaN器件是在实现低特征导通电阻的同时，集成采样功能，显著提升GaN器件的可靠性。

3、项目实施的必要性

（1）本项目有助于公司切入新兴市场，打破国外企业在高端应用领域的垄断地位

由于我国芯片产业发展较晚，加之数字电源管理芯片具有较高的技术壁垒，国内电源管理芯片厂商目前基本采用技术简单、成本较低的模拟类解决方案，应用于消费电子领域及初级工业控制领域。伴随着消费电子类芯片产品赛道逐渐饱和、竞争日趋激烈，积极布局大型服务器与数据中心、基站、光伏逆变器、储能等中高端产品应用领域成为公司巩固和提高在主营产品赛道竞争优势的重要战略选择。

大功率数字电源芯片需要将与真实电源环境相连的模拟环路及数字算法管理相结合，要求技术人员同时掌握数字编程技术，以及电源模拟的环路和调制，具有较高技术壁垒。国内电源管理芯片设计企业在IP设计技术、工艺集成度等，与英飞凌、德州仪器等国外电源管理龙头厂商相比还有差距，下游大功率应用领域供货长期主要依赖进口。本项目通过数字电源管理芯片产品的技术研发与产业化应用，不断提升公司数字电源管理芯片的性能指标并拓展产品品类，逐步填补国内电源管理领域数字化解决方案的空白，对实现中高端应用领域所需数字电源管理芯片的国产替代具有重要的战略意义。

（2）本项目是公司抢占大功率市场份额，形成新的利润增长点的重要举措

近年来，随着数据中心、5G通信、新能源等新兴产业的兴起，数据中心、服务器、基站、光伏逆变器、储能等领域的大规模应用，为电源管理芯片带来显著的增量需求。数字电源管理芯片凭借着更高的灵活性、可扩展性和重复使用性等特点，能够更好满足上述应用场景对于电源效率、集成度以及整体性能的高要求。同时，工业电源管理芯片市场属于高毛利率的新兴成长市场，进口替代空间较大，技术门槛较高。

结合对上述产业的前瞻性深度研究，为全面满足客户的多样化产品需求，公司将依托现有技术平台以及丰富的工业级产品开发经验，在现有产品线基础上不断推陈出新。本项目布局的数字电源管理芯片及配套功率芯片将满足工业市场对于大功率电源管理芯片的市场需求。本项目的实施是公司把握行业发展机遇的重要举措，有利于公司抢占工业场景的市场先机，提升市场覆盖范围，在未来形成新的利润增长点。

（3）本项目是公司进行战略布局的重要决定

集成电路设计行业属于技术密集型行业，是集成电路产业链中创新成果高度集中的重要环节，研发实力在很大程度上决定了公司能否在激烈的市场竞争中取胜。集成电路设计领域产品迭代周期较短，下游终端市场日新月异，如果研发进度滞后，企业将在长期竞争中处于被动地位。相比于国外行业龙头企业，公司在产品丰富度、应用领域方面尚有差距，公司现阶段产品线有待通过持续的新产品研发实现拓展，形成种类更全面、应用更广泛的产品体系。

公司始终坚持根据行业发展方向进行持续创新，提前进行技术研发升级和产品布局。本项目的实施不仅有助于提升公司在电源管理领域的市场份额，还推动公司产品应用领域向数据中心、服务器、基站、光伏逆变器、储能等工业场景跨越。本项目实施后，公司将扩建研发团队，并给予研发充分的资金支持，形成工业级电源管理芯片相关知识产权，进一步提升公司的技术研发水平，拓展产品领域。公司也将通过提供自主可控的高可靠性、高性能电源管理解决方案，持续为客户创造价值，巩固行业地位。

4、项目建设的可行性

（1）国家出台多项政策驱动集成电路产业发展，为本项目提供政策保障

集成电路是各领域信息化、数字化转型建设的基础和核心，是新一轮科技革命和产业变革的关键力量。近年来，我国有关部门相继出台《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》《关于印发制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年）的通知》等多项产业扶持政策，从财税、投融资、研究开发、人才培养、国际合作等多个方面促进我国集成电路产业发展。2021年3月，全国人民代表大会审议通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，强调在“十四五”期间要进一步落实国家战略性科技力量，加强集成电路等基础性核心技术攻关，推动集成电路产业创新发展，进一步为集成电路行业的参与者提供了良好的发展环境。

电源管理芯片作为消费电子、工业、通讯、汽车等产品不可或缺的上游集成电路元件，而数字电源管理芯片以更加优异的性能在现代产业体系构建中的重要地位日益显著。我国集成电路产业政策呈现出的延续性为公司提供了良好的发展环境及政策保障，项目实施具备可行性。

（2）公司深耕于电源管理芯片领域，拥有强大的人才和技术储备

公司成立16年以来，始终专注于电源管理芯片领域，持续增加研发投入，形成了良好的技术和人才积累，实现功率集成电路的工艺、器件、电路、封装和测试的全产业链创新。在人才方面，公司拥有由多名专业理论知识扎实、研发实力强、研发经验丰富的技术人员组成的研发团队，截至2021年12月31日，公司研发人员数量215人，占公司总人员75.44%，核心技术团队中包含3名博士学历人员与67名硕士学历人员。研发经验丰富、长期稳定，配合默契的技术团队为公司的研发工作提供了坚实的保障。

公司拥有博士后企业工作站和江苏省功率集成电路工程技术中心，具备完善成熟的培训体系，对员工提供实践性的内部传帮带式职能培训与外派进修式的专业培训。此外，公司经常举办技术讲座以加深员工之间技术交流。完善的培训和培养体系为公司技术人才团队建设提供了支撑。

在技术方面，公司拥有84项已授权的国内外专利，100项集成电路布图登记，15项原始创新的核心技术，其中5项属国际先进技术水平，分别为智能功率器件高低压集成工艺技术、超低功耗高压启动技术、200V-1200V螺旋形电场均衡场板的器件新结构技术、40V-1200V SmartMOS器件过流保护技术以及600V高压隔离浮置栅半桥驱动技术。本项目将基于电源管理芯片技术基础向工业级数字电源管理芯片领域研发拓展，多年积累的专业技术、人才及管理经验为本项目建设提供了良好依托，项目实施具备可行性。

（3）成功的工业级产品开发经验与开发管理流程为本项目实施提供良好的经验借鉴

公司自成立以来专注于电源芯片领域。2013年，基于第三代“高低压集成技术平台”，公司正式切入工业驱动芯片市场，并于2014年在国内创先量产了内置1000~1200V智能MOS的超高压AC-DC电源芯片，成功进入国网/南网的智能电表和智能断路器市场，率先实现了电表中高压电源芯片的进口替代，产品线进一步丰富，业务规模快速增长。2016年，公司配合行业高端客户的电源开发需求，基于第四代数字化MOS数字式多片高低压集成平台，开发了全新一代数字化内核的多模式电源管理芯片，陆续推出全模式高功率集成原边反馈开关电源芯片、零瓦待机800V工业开关电源芯片和1000V工业级X-cap放电电源芯片等新品。2019年公司针对工业级通讯电源市场，开发了新一代高可靠、耐冲击、可交互的工业级电源管理芯片，为工业级通讯设备电源管理芯片领域实现进口替代、自主可控做出贡献。

2021年公司工控功率类芯片产品收入11,775.51万元，较2020年增长122.83%，占主营业务收入的比例达到15.75%，工业级产品规模及收入占比持续增长。公司工业驱动类芯片的主打系列包括800V智能保护AC-DC电源芯片系列、1000~1200V工业AC-DC电源芯片系列、零瓦待机AC-DC工业电源芯片系列、600V浮置栅驱动电源芯片系列等，面向包括工控设备、电网集中器、服务器、通讯设备、电机设备等多样化的工业场景。

成功的工业级产品开发经验与开发管理流程为本项目实施提供良好的经验借鉴。

（4）广阔的工业市场为募投项目的实施提供了基础

本项目所涉及的电源管理芯片及配套功率芯片被广泛的应用于数据中心、服务器、基站、光伏逆变器、储能等大功率工业场景。

数据中心方面，其建设加快以及服务器的出货量持续上升，带来电源管理芯片显著的增量需求。根据Wind数据，2007年至2020年期间，我国数据中心市场规模实现持续增长，2020年我国数据中心市场规模达到2,238.70亿元，同比增长43.28%。在服务器领域，2020及2021年，我国整体服务器市场保持稳健增长，根据IDC数据显示，2020年我国服务器市场出货量为350万台，同比增长9.8%，其市场规模达到216.49亿美元，同比增长19.0%。2021年上半年，我国服务器市场出货量为170.6万台，同比增长8.9%，其市场规模达到108.1亿美元，同比增长12.1%。

5G通信方面，2020年我国移动通信基站数达到931万个，其中5G基站数量超过71.8万个。截至2021年9月，我国移动电话基站总数达969万个，同比增长5.7%，其中4G基站总数为586万个，占移动基站总数的60.4%，5G基站总数达到115.9万个，占移动基站总数的12.0%。预计到2022年底，我国5G基站将超过200万个，5G的终端连接数将达到6亿。

新能源方面，光伏逆变器是光伏系统中的重要组件，根据IHS Markit数据及预测，2020年全球光伏逆变器的新增及替换整体市场规模为135.7GW，2021年全球光伏逆变器市场规模将达187GW，预计至2025年全球光伏逆变器市场规模有望达到401GW，CARG达21.0%。

由此，广阔的下游应用领域保障了对公司产品的充足需求，为公司发展提供了巨大的市场空间。

5、投资概算

本项目预计建设期为4年，项目总投资48,819.15万元，拟投入募集资金47,294.66万元。项目具体投资情况如下：

序号	项目	指标	单位
1	项目总投资	48,819.15	万元
2	场地购置、装修费用	1,900.00	万元
3	软硬件设备及IP购置	33,928.00	万元
4	研发费用	11,466.66	万元
5	基本预备费	945.89	万元
6	铺底流动资金	578.60	万元

6、实施主体、项目选址和建设期限

本项目实施主体为公司，项目选址定于江苏省无锡市。

7、项目备案及环评情况

本项目的备案、环评事宜正在推进中。

（三）苏州研发中心项目

1、项目概况

电源管理芯片作为先进设备的核心，下游市场对其技术和性能的要求不断提升。本项目拟通过建立前瞻性技术研发中心，建设一支以数模混合电源芯片和宽禁带智能功率器件为技术方向，包含芯片和器件测试团队、系统应用方案团队、软件团队等全方位一体化的研发设计团队。公司着眼功率半导体行业最新前沿技术领域，定位国际先进水平，为公司始终保持市场需求和技术发展的敏感性、精准选择自身战略定位作出前瞻性布局，不断巩固和提高公司在电源管理芯片领域的优势地位。

2、项目建设内容

本项目具体建设目标如下：

本项目拟通过建立前瞻性技术研发中心，建设一支以数模混合电源芯片和宽禁带智能功率器件为技术方向，包含芯片和器件测试团队、系统应用方案团队、软件团队等全方位一体化的研发设计团队。

同时本项目将极大缓解公司目前日益紧张的办公、实验等场地需求，有利于吸引当地优秀芯片设计人才，推动公司长远可持续发展。此外，苏州研发中心的建立也有利于进一步提升公司形象，在客户群中打造良好的品牌影响力，进而推动公司各项业务的顺利开展。

3、项目实施的必要性

（1）本项目是公司拓展下游目标市场和丰富产品线的必然要求

随着新能源汽车等下游应用领域的技术迭代，以及终端产品种类和功能的不断丰富，电源管理芯片的应用场景愈发广泛，同时也增加了对电源管理芯片协调设备内部各模块供电的难度及复杂程度。

新能源汽车领域方面，新能源汽车和智能驾驶的兴起使得整车中电子电气的应用比例日益提升，汽车的电动化、网联化、智能化及共享化带来了新的应用场景与现有配置升级，功能日益强大的处理器以及逐渐增多的系统外设对电源管理提出了更高的要求，这些新增应用也是国内汽车芯片厂商最好的切入机会，将推动车规级电源及电驱动芯片市场规模进入新的发展阶段。同时，不断崛起的新能源汽车相比于传统的燃油车新增了电池、电机、电控“三电”系统，带动大量的电能转换需求，从而推动上游芯片市场显著的增量需求。

工业领域方面，能耗主要来自于电机和数据中心。其中电机包括泵、风机、压缩机、传输机等，电机消耗的能量几乎占工业电力消耗的80%。工业领域对节能的要求，促使电源芯片不断提高转换效率。比如使用变速电机能节省40%的能耗，使用高效的开关电源可以节省35%的能耗，这均是由更先进的电源芯片支撑。随着数据中心的人工智能处理器的推出，供电功率上限不断提升，对电源管理芯片的集成度和效率提出更高的要求。为了满足下游市场多样化的需求，企业需持续增加研发投入以保持竞争优势。

本项目建设通过引进更多的前沿技术人才，购置相应的先进实验设备，坚持专注公司主营业务方向—电源芯片的前沿技术研发，有助于稳固公司自身的技术“护城河”，始终为市场提供最具竞争力的电源芯片产品，从而提升公司在电源芯片领域的市场地位，项目实施具有必要性。

（2）本项目的实施有助于增加公司高端人才储备

集成电路行业是全球信息产业的基础，在产业资本的驱动下，已经逐渐成为衡量一个国家或地区综合竞争力和经济表现的重要标志。其广泛应用于人们的生活当中，推动了电子时代的发展。集成电路行业属于技术密集型高新技术产业，对于芯片设计行业，人才是技术研发的核心，企业需要不断引进和培养优秀的行业人才以维持产品的科技能力。因此，人才团队的建设和稳定将对公司产品线的突破和创新起到推动作用。

人才紧缺是制约高新技术产业发展的最大痛点之一，为了满足更新迭代周期快的下游市场，公司拟加大研发投入，构建高精尖的人才团队，一方面开展模拟电源管理芯片的更新迭代，另一方面进行数字电源管理芯片的研发，进一步推动对芯片设计行业人才的需求。

本项目将把人才环境建设作为发展战略目标，提供完善的研发环境和管理体系，研究和制定多种灵活的人才引进和培养政策，为公司的研发开展和项目建设提供有效支撑。

（3）本项目建设有助于产业减少对国外技术的依赖

电源管理芯片是电子设备重要的组成部分，为设备的运行输入源源不断的动力，应用领域广泛，如工业领域、家电领域、通讯领域等皆需要电源的使用。目前，中国大陆电源管理芯片设计企业处于上升期，在中小功率相关产品已经实现部分国产化，但大部分电源管理芯片的供应来自于进口，国产厂商发展方兴未艾。因此，企业需要增强技术能力和储备，增加自有知识产权对产品进行拓展研发和升级以满足下游产业的大功率发展趋势。

电源管理芯片行业具有研发周期长、技术难度高等特点，持续的研发投入将为企业带来巨大的竞争优势，公司在电源管理行业深耕16年，积累了大量的行业经验，其中不乏国际先进水平的核心技术。基于现有技术的基础上进行研发有利于公司突破更多技术瓶颈，实现更多产品的国产替代。项目的实施是对公司现有技术水平的继续延伸，有利于提高公司技术储备，构建技术壁垒，巩固公司的竞争地位。

此外，随着公司的不断发展壮大以及技术开发环境要求的不断提升，本项目拟购置新场地，搭建更为完善的实验环境，充分保障技术研发的顺利进行。本项目建设是提升公司整体研发水平，增加自主知识产权，助力我国电源管理芯片行业实现国产替代的重要举措。

4、项目建设的可行性

（1）国家政策的有力支持为本项目实施提供了良好的政策环境

集成电路产业是信息技术产业的核心，电源管理芯片是通电类产品的电能供应中枢和纽带，负责所需电能的变换、分配、检测和控制等功能。实现电源管理领域高端产品细分赛道的国产化，对提升我国在国际芯片舞台上的竞争力具有重大的战略意义。

为了增强我国集成电路的竞争力和自主化，我国政府相继出台了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《国家集成电路产业发展推进纲要》《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》等多项鼓励性政策，从财税、技术、人才、应用、国际合作等多方面予以优惠，持续促进我国集成电路产业发展。

2021年3月，全国人民代表大会审议通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，进一步明确了集成电路领域技术攻关和创新发展在“十四五”期间的重要地位。我国集成电路产业的政策红利显示出了良好的延续性，有利于推动我国电源管理芯片行业的健康发展，为本项目顺利实施提供了可靠的政策保障。

（2）公司核心技术积累为本项目研发目标的顺利实现提供了技术基础

公司是一家专业从事功率集成电路及其解决方案的定义、设计、研发的高新技术企业，在多年的电源管理芯片技术和产品开发实践中，公司取得了丰富的技术及经验积累。截至2021年12月31日，公司累计取得国内外专利84项，其中发明专利65项，另有集成电路布图设计专有权100项。

目前，公司建立了科技创新和知识产权管理的规范体系，在数字/模拟电路设计、半导体器件及工艺设计、可靠性设计、器件模型提取等方面积累了众多核心技术，迭代开发出了4代核心技术平台。此外，公司拥有经验丰富的研发团队，公司核心团队均具有十年以上集成电路行业研发经验，拥有较强的研发实力。自公司成立以来，公司核心团队保持稳定。丰富的技术积累及研发创新能力、优秀的技术研发团队是募投项目顺利实施的重要支撑。

（3）募投项目所在地具备长三角集成电路企业集群优势

我国集成电路主要有四个产业集聚区，分别是以上海为中心的长三角、以北京为中心的环渤海、以深圳为中心的泛珠三角和以武汉、成都为代表的中西部区域。本项目所在地苏州地处长三角，其集成电路产业已形成以“芯片设计-晶圆制造-封装测试”为核心，以设备、原材料及服务产业为支撑的集成电路产业链，是国内产业链较完整的区域之一，有利于公司研发项目的顺利开展以及对产业化项目提供技术支持。

首先，长三角区域半导体企业集聚度高。芯片生产的流程包括芯片设计、生产、封测等步骤，而生产又涉及到原材料采购、加工和清洗等步骤，产业集聚效应减少了产品的运输风险，且提高了生产效率。其次，产业集群更有利于吸引业内人才和培养人才。公司所在的集成电路行业属于技术密集行业，人才梯队建设是企业长期健康发展的基础，由于长三角地区产业链完整，具有人才聚集效应，能够为公司未来的技术研发项目提供更好地支撑。

本项目拟建地址为江苏省苏州市，该地区是国内领先的高新技术成果转化孵化基地，汇聚了多家大中型企业，商业氛围浓厚，为公司吸引高素质的专业人员和多元化人才提供了便利条件。

同时，公司拟在公司现有办公地点附近新购置5,000平方米办公区域用于研发中心办公场地。苏州市地理位置优越，交通便利，各种配套设施齐全，房产交易较为活跃，公司较易取得合适的房产，项目具备可行性。

5、投资概算

本项目预计建设期为4年，项目总投资24,644.15万元，拟投入募集资金24,160.93万元。项目具体投资情况如下：

序号	项目	指标	单位
1	项目总投资	24,644.15	万元
2	场地购置、装修费用	10,350.00	万元
3	软硬件设备及IP购置	4,371.15	万元
4	研发费用	9,439.78	万元
5	基本预备费	483.22	万元

6、实施主体、项目选址和建设期限

本项目实施主体为公司的全资子公司苏州博创集成电路设计有限公司，项目选址定于江苏省苏州市。

7、项目备案及环评情况

本项目的备案、环评事宜正在推进中。

(二十九) 三、本次募集资金投资属于科技创新领域

（一）本次募集资金主要投向科技创新领域

公司为集成电路设计企业，主营业务为电源管理集成电路的研发和销售。公司专注于开发电源管理集成电路，实现进口替代，为客户提供高效能、低功耗、品质稳定的电源管理集成电路产品，推动整机的能效提升和技术升级。目前公司已开发出1200多个型号的产品。公司主营业务属于科技创新领域。

公司本次募集资金投资项目为新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目、工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目和苏州研发中心项目，旨在完善市场布局，提高公司核心技术竞争力、加强项目产品线配套封测产能保障，并新建苏州研发中心以满足公司利用长三角集成电路企业集群优势、探索前沿技术研究的需求，持续保持公司的科创实力。因此，本次募集资金主要投向科技创新领域，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，服务于国家创新驱动发展战略及国家经济高质量发展战略。

公司本次募集资金投向不用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资和类金融业务。

（二）募投项目促进公司科技创新水平提升

公司重视自身产品技术和性能的不断升级，进一步突出公司电源管理芯片设计方面积累的丰富经验、优秀的人才和研发储备的优势，并为此制定中期战略发展规划。

本次募投项目包括新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目、工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目和苏州研发中心项目。通过本次募投项目的实施，公司将发挥自身研发创新优势，加速提升公司在电源管理芯片设计领域的技术水平和产业化能力，从而推动电源管理芯片产品的国产化，保障产业链安全，加快国产替代、自主可控进程，同时新建苏州研发中心以利用长三角集成电路企业集群优势、探索前沿技术研究，持续提升公司科技创新实力。

(三十) 四、结论

综上所述，公司认为：公司本次募集资金投向方案中所列示募集资金投向均属于科技创新领域，均有助于提高公司科技创新能力，强化公司科创属性，符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定的要求。

无锡芯朋微电子股份有限公司
董事会
2022年3月18日

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2022-026

无锡芯朋微电子股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡芯朋微电子股份有限公司（下称“公司”）2022年度向特定对象发行A股股票事项已经公司于2022年3月17日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下：

经自查，公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性文件的规定而被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司
董事会
2022年3月18日

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2022-027

无锡芯朋微电子股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为600.00万元人民币。出席会议的董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司预计2022年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。本次董事会审议公司2022年关联交易事项的决策程序，符合有关法律法规和公司章程的规定，公司独立董事同意《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。

（二）本次日常关联交易预计的金额和类别

本次公司预计与关联方发生日常关联交易金额不超过600.00万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售原材料	普敏半导体科技（上海）有限公司及其子公司	600.00	1.91	4.52	22.54	0.07	业务规模扩大采购量增加

（三）前次关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售原材料	普敏半导体科技（上海）有限公司及其子公司	0	22.54	根据实际采购需求实施

二、关联人基本情况和关联关系

1、基本情况

企业名称	普敏半导体科技（上海）有限公司
性质	有限责任公司
法定代表人	曾宪伟
注册资本	118.3432万元
成立日期	2021年1月25日
住所	中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路2305号B幢901室
经营范围	从事半导体科技、计算机科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，集成电路、电子产品、计算机软硬件的研发、设计和销售，电子元器件、通讯产品及辅助设备的销售，企业管理咨询，商务信息咨询，货物进出口，技术进出口。

2、关联关系：公司参股普敏半导体科技（上海）有限公司，持有10%股权，委派一名董事。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联人销售原材料。公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

（二）关联交易的公允性及合理性

公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

（三）关联交易的持续性

公司将与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

“上述关于预计2022年度日常关联交易事项已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，董事会、监事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次关联交易事项无需经过股东大会审议。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述，保荐机构对公司预计2022年度日常关联交易事项无异议。”

六、备查文件目录

1、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关议案的事前认可意见；

2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见；

3、华林证券股份有限公司关于无锡芯朋微电子股份有限公司预计2022年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司
董事会
2022年3月18日

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2022-028

无锡芯朋微电子股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，会议审议通过了公司2022年度向特定对象发行A股股票的相关议案。

《无锡芯朋微电子股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》《无锡芯朋微电子股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》等相关文件已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

本次公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行A股股票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司
董事会
2022年3月18日